

Title (en)

Contact assembly for electrically contacting a circuit board

Title (de)

Kontaktanordnung zum elektrischen Kontaktieren einer Leiterplatte

Title (fr)

Agencement de contact pour la mise en contact électrique d'une carte de circuit imprimé

Publication

EP 2693570 A1 20140205 (DE)

Application

EP 13177445 A 20130722

Priority

DE 102012213806 A 20120803

Abstract (en)

The arrangement (14) has contact elements (15) for electrically contacting a printed circuit board (PCB) (10). The contact elements include electrically conductive contact surfaces (18) for electrical contacting of a spring element of a plug. The contact surfaces are provided at oppositely lying surfaces of the PCB. The contact elements include spacer elements (16a), which are carried by the PCB and carry the contact surfaces, so that contact surfaces include a spacing to a surface of the PCB. The spacer elements are curved over a surface of the PCB.

Abstract (de)

Eine Kontakthanordnung 14 umfasst eine Leiterplatte 10 und ein Kontaktelement 15 zum elektrischen Kontaktieren der Leiterplatte 10. Das Kontaktelement 15 weist eine Kontaktfläche 18 zum elektrischen Kontaktieren eines komplementären Kontaktelements 26 einer Kontaktiereinrichtung 22 auf. Das Kontaktelement 15 weist ein Abstandselement 16a bis 16p auf, das von der Leiterplatte 10 getragen wird und das die Kontaktfläche 18 trägt, so dass die Kontaktfläche 18 einen Abstand zur Oberfläche der Leiterplatte 10 aufweist.

IPC 8 full level

H01R 12/57 (2011.01); **H01R 12/71** (2011.01); **H01R 13/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 12/57 (2013.01); **H01R 12/718** (2013.01); **H01R 13/24** (2013.01)

Citation (search report)

- [XAI] US 2012171909 A1 20120705 - HARADA YOHEI [JP]
- [XI] EP 1577980 A1 20050921 - TYCO ELECTRONICS AMP KK [JP]
- [X] DE 102009005949 A1 20100722 - WUERTH ELEKTRONIK ICS GMBH & C [DE]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2693570 A1 20140205; **EP 2693570 B1 20170426**; DE 102012213806 A1 20140206

DOCDB simple family (application)

EP 13177445 A 20130722; DE 102012213806 A 20120803